|  |
| --- |
| [中国IC设计市场现状调研与发展前景分析报告（2024-2030年）](https://www.20087.com/2/17/ICSheJiShiChangXuQiuFenXiYuFaZha.html) |



#### [中国市场调研网](https://www.20087.com/)

[www.20087.com](https://www.20087.com/)

一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 名称： | [中国IC设计市场现状调研与发展前景分析报告（2024-2030年）](https://www.20087.com/2/17/ICSheJiShiChangXuQiuFenXiYuFaZha.html) |
| 报告编号： | 1936172　　←电话咨询时，请说明该编号。 |
| 市场价： | 电子版：8500 元　　纸介＋电子版：8800 元 |
| 优惠价： | 电子版：7600 元　　纸介＋电子版：7900 元　　可提供增值税专用发票 |
| 咨询电话： | 400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099 |
| Email： | Kf@20087.com |
| 在线阅读： | [<https://www.20087.com/2/17/ICSheJiShiChangXuQiuFenXiYuFaZha.html>](https://www.20087.com/2/95/ZhiNengXiWanJiShiChangQianJingYuCe.html) |
| 温馨提示： | 订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。 |

二、内容简介

　　集成电路（IC）设计行业是半导体产业的创新引擎，近年来随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的兴起，IC设计迎来了前所未有的发展机遇。先进制程技术的突破，如7nm、5nm乃至更小的节点，使得IC能够集成更多晶体管，实现更高性能和更低功耗。同时，EDA（Electronic Design Automation）工具的智能化，提高了设计效率和准确性。
　　未来，IC设计将更加注重异构集成和定制化。随着摩尔定律逼近物理极限，通过将不同类型的功能模块（如CPU、GPU、AI加速器）集成在同一芯片上，可以继续提升系统性能。同时，针对特定应用的专用芯片（ASIC）和FPGA（Field-Programmable Gate Array）将更加流行，以满足个性化和高效能计算的需求。
　　《[中国IC设计市场现状调研与发展前景分析报告（2024-2030年）](https://www.20087.com/2/17/ICSheJiShiChangXuQiuFenXiYuFaZha.html)》基于多年监测调研数据，结合IC设计行业现状与发展前景，全面分析了IC设计市场需求、市场规模、产业链构成、价格机制以及IC设计细分市场特性。IC设计报告客观评估了市场前景，预测了发展趋势，深入分析了品牌竞争、市场集中度及IC设计重点企业运营状况。同时，IC设计报告识别了行业面临的风险与机遇，为投资者和决策者提供了科学、规范、客观的战略建议。

第一章 IC设计行业概述
　　第一节 IC设计行业特点
　　第二节 IC设计行业发展趋势

第二章 中国IC设计行业发展环境分析
　　第一节 经济环境分析
　　　　一、国民经济运行情况gdp
　　　　二、消费价格指数cpi、ppi
　　　　三、全国居民收入情况
　　　　四、恩格尔系数
　　　　五、工业发展形势
　　　　六、固定资产投资情况
　　　　七、财政收支状况
　　　　八、中国汇率调整
　　第二节 政策环境分析
　　　　一、行业政策影响分析
　　　　二、相关行业标准分析
　　第三节 IC设计行业社会环境分析
　　　　一、人口环境分析
　　　　二、教育环境分析
　　　　三、文化环境分析
　　　　四、生态环境分析
　　　　五、中国城镇化率
　　　　六、居民的各种消费观念和习惯
　　第四节 2024年中国IC设计行业技术环境分析

第三章 全球及中国IC设计市场
　　第一节 全球IC设计市场
　　第二节 中国台湾IC设计市场
　　第三节 中国大陆IC设计市场
　　　　一、中国IC设计市场概况
　　　　二、中国手机IC市场
　　　　三、中国智能卡IC市场
　　　　四、中国电源管理芯片市场

第四章 基础类IC设计企业
　　第一节 上海贝岭（600171，shanghai belling co.， ltd.）
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第二节 无锡华润微电子
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第三节 华微电子（600360，jilin sino-mICroelectronICs co.， ltd.）
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第四节 晶门科技（，solomon system）
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第五节 北京君正集成电路股份有限公司（上市通过审核）
　　第六节 北京神州龙芯集成电路设计有限公司
　　第七节 苏州国芯科技有限公司

第五章 通讯类IC设计企业
　　第一节 国民技术
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第二节 锐迪科（rda mICroelectronICs，inc）
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第三节 海思
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第四节 展讯
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第五节 联芯科技有限公司
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析

第六章 多媒体IC设计企业
　　第一节 中星微电子
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第二节 珠海炬力
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第三节 士兰微
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第四节 上海泰景
　　第五节 深圳芯邦
　　第六节 上海格科微
　　第七节 北京海尔
　　第八节 杭州国芯

第七章 智能卡IC设计企业
　　第一节 远望谷（002161）
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第二节 上海复旦微电子
　　第三节 大唐微电子
　　第四节 上海华虹
　　第五节 北京同方微电子有限公司

第八章 其他类型IC设计企业
　　第一节 欧比特
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第二节 福星晓程（300139）
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第三节 长电科技
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析
　　第四节 东软载波
　　（1）企业发展简况分析
　　（2）企业经营情况分析
　　（3）企业经营优劣势分析

第九章 2024-2030年中国IC设计发展前景预测
　　第一节 行业发展趋势预测
　　第二节 未来企业竞争格局
　　第三节 行业资源整合趋势
　　第四节 产业链竞争态势发展预测

第十章 2024-2030年中国IC设计行业投资机会与风险预警
　　第一节 投资环境的分析与对策
　　第二节 投资机遇分析
　　第三节 投资风险分析
　　　　一、政策风险
　　　　二、经营风险
　　　　三、技术风险
　　　　四、进入退出风险
　　第四节 投资策略与建议
　　　　一、企业资本结构选择
　　　　二、企业战略选择
　　　　三、投资区域选择
　　第五节 中~智林~－专家投资建议

图表目录
　　图表 IC 产业垂直分工演化过程
　　图表 IC设计在半导体产业链中的价值占比
　　图表 IC设计技术发展进程
　　图表 IC系统性能和集成度
　　图表 3c应用领域关键IC整合趋势
　　图表 人机接口关键半导体组件及主要供货商
　　图表 全球25大IC设计商
　　图表 2018-2023年中国台湾IC设计产业产值
　　图表 2024年中国台湾IC设计产业前10大厂商营收及成长率
　　图表 2018-2023年中国IC设计产值变化趋势图
　　图表 中国IC市场应用结构
　　图表 2018-2023年国内手机出货量
　　图表 国内主要智能卡芯片供应商
　　图表 上海贝岭主要经济指标走势图
　　图表 上海贝岭经营收入走势图
　　图表 福星晓程盈利指标走势图
　　图表 福星晓程负债情况图
　　图表 福星晓程负债指标走势图
　　图表 福星晓程运营能力指标走势图
　　图表 福星晓程成长能力指标走势图
　　图表 长电科技主要经济指标走势图
　　图表 长电科技经营收入走势图
　　图表 长电科技盈利指标走势图
　　图表 长电科技负债情况图
　　图表 长电科技负债指标走势图
　　图表 长电科技运营能力指标走势图
　　图表 长电科技成长能力指标走势图
　　图表 东软载波主要经济指标走势图
　　图表 东软载波经营收入走势图
　　图表 东软载波盈利指标走势图
　　图表 东软载波负债情况图
　　图表 东软载波负债指标走势图
　　图表 东软载波运营能力指标走势图
　　图表 东软载波成长能力指标走势图
略……

了解《[中国IC设计市场现状调研与发展前景分析报告（2024-2030年）](https://www.20087.com/2/17/ICSheJiShiChangXuQiuFenXiYuFaZha.html)》，报告编号：1936172，

请致电：400-612-8668、010-66181099、66182099、66183099，

Email邮箱：Kf@20087.com

详细介绍：<https://www.20087.com/2/17/ICSheJiShiChangXuQiuFenXiYuFaZha.html>

了解更多，请访问上述链接，以下无内容！